

2026年度中国科学院微电子研究所岗位需求

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
抗辐照器件技术重点实验室	模拟电路(IP)设计工程师	微电子相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展精密信号链路中模拟、混合信号等电路的设计开发与设计自动化研究，包括关键技术攻关、电路设计与仿真验证、版图设计、流片、测试等； 协助开展科研项目组织、策划、申报、实施、结题及其他各项科研工作； 撰写高水平学术论文、申请发明专利，参与研究生培养； 配合落实课题组年度工作计划； 完成领导交办的其他工作。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 博士研究生，具有丰富的微电子和集成电路领域的专业背景知识； 原则上年龄不超过35周岁，有主持精密信号链模拟集成电路设计项目的应聘者可适当放宽年龄限制； 熟练掌握模拟、数模混合电路设计流程及方法，对数字电路有一定了解； 熟练掌握Spectre、Virtuoso和Calibre软件操作； 熟悉精密运算放大器、ADC、电压基准源、线性稳压器等电路设计流片经验者优先； 对电路研究工作具有创新意识，主动性与团队协作意识。 	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	功率集成电路(IP)设计工程师	微电子相关专业	<p>岗位职责：</p> <p>主要从事智能功率集成电路设计工作，负责功率集成电路设计、电路仿真、版图设计等工作。对智能功率集成电路项目的进度和质量负责，完成相关文档的撰写。</p> <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 微电子等相关专业，博士研究生； 熟练掌握数字集成电路、模拟集成电路、半导体器件等相关知识； 负责完成相关Power IC电路的设计，验证，测试，debug等具体工作； 具备独立工作能力，有功率集成电路设计经验者优先； 熟悉Cadence Virtuoso 设计仿真环境者优先。 	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	数字单元库设计工程师	微电子相关专业	<p>岗位职责：</p> <p>负责标准单元库的电路设计、版图设计、特征化及质量检查，优化和维护单元库，开发标准单元库，生成后端设计包，完成质量检查和发布，维护已发布，为数字前端和后端提供技术支持。</p> <p>岗位要求：</p> <p>博士研究生，年龄不大于35周岁（特别优秀者可以放宽至40周岁），专业为微电子学与固体电子学、集成电路工程、计算机科学与技术等，熟悉Virtuoso、Liberate、Laker等数字单元库设计EDA工具，掌握Python、PERL等编程语言，具备数字单元设计相关工作经验者优先。</p>	gaojiantou@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
抗辐照器件技术重点实验室	器件与模型工程师	微电子相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展先进器件与芯片的辐照损伤多尺度动力学理论与电-热-辐射同源性理论研究，发展基于人工智能的辐照性能退化预测模型，实现芯片抗辐照能力的高通量、高精度仿真预测与可靠性评估； 开展基于低维材料的异质集成技术研究，聚焦新材料、新结构、新工艺协同创新研究，显著提升器件与电路的电学性能与抗辐照能力； 负责特种器件及先进器件工作机理及模型研究； 申请相关科研项目，发表高水平论文，负责团队建设等工作； 完成领导交办的其他任务。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 微电子、电子、材料等相关专业背景，博士研究生； 熟悉先进MOS器件工艺流程，能够借助TCAD软件开展器件工艺仿真、电热特性研究； 能够熟练使用相关器件测试设备及TCAD仿真软件与参数提取软件等； 有参与科研项目的经历，熟悉项目申报、实施、结题等流程； 具备良好的技术文档及中英文文献读写能力； 具有责任心、逻辑分析能力、创新精神，具备良好的沟通及团队合作能力。 	gaojiantou@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	射频模拟芯片设计工程师	微电子相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 深入研究射频、毫米波、太赫兹锁相环和收发机芯片设计原理，提出电路拓扑及或系统架构的创新性设计； 射频及模拟芯片的设计与仿真，架构和结构的优化，主要包含Wireline/Wireless Transceiver Design，参与完成版图布局和设计文档撰写； 基于研究成果，在领域内有影响力的会议/期刊发表论文； 协助指导硕士、博士研究生。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 知识结构完整，具备系统的数模混合集成电路知识体系，具备扎实的射频及信号处理系统理论； 具备芯片研发关键环节（系统建模、功能仿真、性能评估等）丰富经验，熟练运用芯片设计全流程EDA工具； 拥有丰富芯片测试经验，熟练操作高端频谱分析仪、示波器等先进测试设备，掌握PCB测试板设计方法； 具备丰富流片经验，有在先进工艺中主导芯片研发全流程并成功交付的经历； 具备研究报告及项目申请书撰写能力； 熟悉电路设计EDA软件使用、具备独立进行全流程电路设计相关经验，有成功流片经历或发表高水平论文者优先。 	gaojiantou@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
感知中心	人工智能芯片设计工程师	计算机及集成电路设计等	岗位职责： 1、负责大算力类脑芯片体系架构设计； 2、负责大算力类脑芯片RTL设计实现； 3、相关科研项目申请。 岗位要求： 1、博士学位，计算机及集成电路设计相关专业教育背景； 2、具有处理器体系架构设计经验； 3、熟悉SNN、神经元等类脑设计技术； 4、具备良好的团队协作精神，能够独立解决问题，承担项目责任； 6、良好的英语读写能力，能够撰写英文文章； 5、在国内外学术或者行业内具有一定影响力。	hehuan@ime.ac.cn
感知中心	人工智能算法研究工程师	计算机及集成电路设计等	岗位职责： 1、负责CNN、Transformer、SNN等算法的训练推理设计、优化； 2、负责CNN、Transformer、SNN等算法的算子提取，硬件匹配； 3、相关科研项目申请。 岗位要求： 1、博士学位，计算机及集成电路设计相关专业教育背景； 2、具有软硬件协同设计的经验； 3、熟悉人工神经网络、脉冲神经网络等人工智能算法； 4、具备良好的团队协作精神，能够独立解决问题，承担项目责任； 5、良好的英语读写能力，能够撰写英文文章； 6、在国内外学术或者行业内具有一定影响力。	hehuan@ime.ac.cn
感知中心	数字集成电路设计工程师	计算机及集成电路设计等	岗位职责： 1、负责通用主控芯片、专用处理芯片设计； 2、负责RTL设计与验证； 3、相关技术文档及科技报告撰写。 岗位要求： 1、硕士及以上学历，计算机及集成电路设计相关专业教育背景； 2、具有数字集成电路设计经验，熟悉前后端设计流程； 3、熟练使用Verilog硬件描述语言及相关EDA工具； 4、熟练使用FPGA进行验证； 5、具备良好的团队合作精神，能够独立解决问题，承担项目责任； 6、良好的英语读写能力，能够撰写英文文章。	hehuan@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
感知中心	模拟集成电路设计	微电子	岗位职责： 1、负责模拟电路的设计与开发，包括但不限于信号调理、数据转换器等模块； 2、利用仿真工具（如Cadence Spectre、HSPICE等）进行电路仿真，确保电路设计符合功能与性能要求； 3、参与芯片的调试与测试，解决芯片在研发过程中遇到的技术难题； 4、撰写设计文档、测试报告及相关技术文档，确保项目文档的完整性和准确性。 岗位要求： 1、拥有微电子或相关领域的博士学位； 2、具有模拟集成电路设计经验，熟悉CMOS工艺； 3、精通模拟电路设计，对信号调理、数据转换等电路有深入理解； 4、熟练掌握Cadence Virtuoso、MATLAB等EDA工具的使用； 5、具备良好的团队合作精神，能够独立解决问题，承担项目责任； 6、良好的英语读写能力，能够撰写英文文章。	hehuan@ime.ac.cn
感知中心	低功耗集成电路设计工程师	计算机及集成电路设计等	岗位职责： 1、负责通用主控处理器低功耗设计； 2、负责低功耗SRAM设计； 3、相关技术文档及科技报告撰写，协助项目申请。 岗位要求： 1、博士学位，计算机及集成电路设计相关专业教育背景； 2、具有低功耗集成电路设计经验，熟悉前后端设计流程； 3、熟练使用Verilog硬件描述语言及相关EDA工具； 4、熟练使用FPGA进行验证； 5、具备良好的团队合作精神，能够独立解决问题，承担项目责任； 6、良好的英语读写能力，能够撰写英文文章。	hehuan@ime.ac.cn
感知中心	硬件设计工程师	电子、信息、计算机	岗位职责： 1、负责音视频系统PCB原理图及版图设计； 2、负责自研芯片的验证PCB原理图及版图设计； 3、负责元器件选型及layout； 4、相关技术文档及科技报告的撰写。 岗位要求： 1、硕士及以上学历，电子、信息、计算机等相关专业教育背景； 2、具有PCB设计以及layout经验； 3、熟悉AD、Cadence等PCB设计工具； 4、熟悉SI和PI仿真优先； 5、具备良好的团队协作精神，能够独立解决问题。	hehuan@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
感知中心	射频集成电路设计工程师	微电子或电磁场与微波技术	岗位职责： 1、设计并实现高性能射频收发芯片； 2、使用仿真工具进行电路建模与性能评估，优化设计方案； 3、参与芯片的测试验证，协助解决集成阶段的技术问题； 4、编写详细的设计文档和技术报告，支持项目文档管理。 岗位要求： 1、拥有微电子或相关领域的博士学位； 2、具有射频集成电路设计经验，熟悉CMOS或化合物工艺； 3、精通射频电路设计，特别是放大器、混频器、振荡器等核心模块； 4、能够熟练使用Cadence Virtuoso、ADS或其他EDA工具进行仿真和设计； 5、具备良好的团队协作精神，能够独立解决问题，承担项目责任； 6、良好的英语读写能力，能够撰写英文文章。	hehuan@ime.ac.cn
重点实验室	器件工艺与集成特别研究助理	微电子学与固体电子学	岗位职责： 1. 开展新新型存储器工艺开发及可靠性优化研究； 2. 围绕新型存储器件实验与测试、器件模型与机理研究，器件与电路的协同设计方法开展研究。 岗位要求： 1. 具备物理学、半导体物理、半导体制造等相关知识背景和追踪国际前沿科研成果的能力，具有方向建设能力； 2. 熟练掌握CMOS工艺制造的流程和相关技术； 3. 熟练掌握各类存储器的机理、可靠性及集成等理论知识； 4. 熟练应用相关测试仪器和表征手段等。	zhangkangwei@ime.ac.cn
重点实验室	新范式智能计算芯片特别研究助理	集成电路设计	岗位职责： 1. 基于新原理器件的存储与计算IP，设计新型张量处理芯片以及SoC芯片； 2. 发展基于新原理器件与新型存储/计算IP的行为级模型、构建新原理张量处理架构的系统仿真器； 3. 面向先进智能计算模型，发展新范式计算芯片与系统。 岗位要求： 1. 深入理解现有主流张量处理架构（GPU与TPU等）及其智能模型加速的原理与方法； 2. 熟练掌握集成电路设计所需的EDA工具，具有实际SoC流片经验者优先； 3. 具有良好的人际沟通能力和团队协作能力。	zhangkangwei@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
重点实验室	基于新型器件的存算一体技术、新型智能算法、芯片架构设计等特别研究助理	微电子学、计算机技术	岗位职责： 1. 在导师的指导下产出具有学术价值或应用价值的研究成果； 2. 参与或独立申请并承担国家级（如国家自然科学基金）、省部级或横向合作课题的核心研究，负责芯片设计、实验操作、文献梳理等关键环节。 岗位要求： 1. 从事微电子芯片领域研究； 2. 不超过30岁、博士学历、工作经历从事科研3~5年； 3. 熟练掌握一类或者几类人工智能算法，并有一篇以上学术性代表文章。	zhangkangwei@ime.ac.cn
重点实验室	检验工程师	电子科学与技术、自动化、微电子、物理电子学	岗位职责： 1. 任检验员一职，对光掩模产品进行检验与维修，保证光掩模产品的出厂质量； 2. 对检验完成的合格掩模版进行清洗包装； 3. 对光掩模客户的确认，保证客户信息流程单与成品掩模版相对应，不混淆，确保订单的顺利交付； 4. 光掩模复制及工艺控制； 5. 按照光掩模客户要求拟定合同，开具发票； 6. 完成领导交办的其他工作。 岗位要求： 1. 具有微细加工、光掩模相关知识； 2. ISO9001检验员相关知识； 3. 熟练掌握查版修版技术； 4. 能熟练运用office办公软件； 5. 踏实认真仔细，有责任心，诚实守信，爱岗敬业； 6. 有责任感、服务意识、较强的团队精神。	zhangkangwei@ime.ac.cn
高频高压中心	模拟IC设计工程师	微电子相关专业	岗位职责： 主要从事模数转换器(ADC)技术研究，进行项目申请、方案制定、模块划分、关键电路设计等工作。 岗位要求： 具有扎实的模数混合集成电路基础、具有通用模数混合电路设计经验、熟悉电路仿真环境及EDA工具(Modelsim/Cadence/calibre/Vcs等)；熟悉数模混合集成电路原理、版图设计；有ADC/DAC、PLL、高速Serdes设计流片经验者优先；有40nm及以下流片经验者优先。	gpgyhr@ime.ac.cn
高频高压中心	数字IC设计工程师	微电子相关专业	岗位职责： 主要从事模数转换器(ADC)技术研究，进行项目申请、方案制定、模块划分、关键电路设计等工作。 岗位要求： 1. 掌握数字IC分析和设计方法，能熟练使用相关EDA工具进行电路设计、仿真验证和版图设计，具有实际数字IC设计经验； 2. 具有高速高精度数字IC流片经验者优先。	gpgyhr@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
高频高压中心	高速串行接口电路模拟电路设计、相干光收发机模拟电路设计工程师	微电子学与固体电子学、电子科学与技术	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责高速SerDes模拟前端关键电路设计与研发，包括但不限于发射机电路、接收机均衡器（CTLE/DFE）、时钟数据恢复（CDR）、锁相环（PLL）及电压控制振荡器（VCO）等电路设计； 根据所负责电路模块的指标，完成电路设计，仿真优化、版图绘制及后仿真验证，确保电路性能、功耗和面积达到设计目标，并与数字设计及版图工程师紧密协作，完成芯片的流片。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历，具备半导体物理、数模混合集成电路等相关知识背景； 具有高速串行接口和高速电路相关技术学习经历； 熟练使用集成电路设计相关软件，如Cadence、Caliber等； 可以应用测试设备，如示波器、误码仪、频谱仪、网络分析仪等； 能够完成高速数模混合电路芯片的开发。 	gpgyhr@ime.ac.cn
高频高压中心	高速串行接口电路数字电路设计、相干光收发机数字设计工程师	微电子学与固体电子学、电子科学与技术	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责高速SerDes数字信号处理（DSP）模块的设计与实现，包括但不限于数字控制环路（如CDR）、自适应均衡算法、链路训练状态机、误码率测试（BERT）等电路设计； 使用Verilog/SystemVerilog进行RTL代码编写、综合、形式验证及静态时序分析（STA），确保设计满足功能、时序和功耗要求； 与模拟工程师紧密协作，定义数模混合接口的规格，并协助完成芯片顶层混合仿真及协同验证； 能够参与芯片测试方案制定、FPGA原型验证及芯片调试。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历，具备半导体物理、数模混合集成电路等相关知识背景； 具有高速串行接口和高速电路相关技术学习经历； 熟练使用集成电路设计相关软件，如Cadence、Caliber等； 可以应用测试设备，如示波器、误码仪、频谱仪、网络分析仪等； 能够完成高速数模混合电路芯片的开发。 	gpgyhr@ime.ac.cn
高频高压中心	射频集成电路设计工程师	微电子相关专业	<p>岗位职责：</p> <p>毫米波/太赫兹相关芯片设计与测试、超高速混合信号集成电路设计与测试。</p> <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 具有硕士及以上学历； 熟悉毫米波前端相关芯片设计、测试与应用； 熟练掌握ADS、Cadence等仿真软件； 专业技术扎实，了解半导体器件物理。 	gpgyhr@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
高频高压中心	先进氮化物电子器件和电路研究博士后	微电子学、半导体物理	<p>岗位职责： 新结构GaN基功率器件设计与研制；氮化物电力电子材料物理和器件物理研究；宽禁带与超宽禁带器件高温高压与抗辐照可靠性和失效机理研究；高水平英文SCI论文撰写与修改；国家级项目的策划与申请。</p> <p>岗位要求： 1. 热衷于科学研究，具备扎实的半导体物理和器件物理基础知识； 2. 熟悉功率器件的电学表征方法，界面态/体缺陷分析技术，以及器件仿真方法； 3. 具备较高的科技英语论文撰写能力； 4. 具备科研项目的申请经历。</p>	gpgyhr@ime.ac.cn
高频高压中心	GaN微波器件与电路设计工程师	微电子学、微波器件与电路、半导体物理	<p>岗位职责： 1. GaN微波器件设计与研制； 2. 掌握氮化物射频器件与电路，物理研究； 3. 超高频器件与电路；宽禁带与超宽禁带器件高温高压与抗辐照可靠性和失效机理研究； 4. 高水平英文SCI论文撰写与修改； 5. 国家级项目申请。</p> <p>岗位要求： 1. 热爱科研工作，动手能力强，具备扎实的半导体物理和器件物理基础知识； 2. 掌握射频器件与电路测试技术； 3. 熟悉电路设计； 4. 具备英语学术论文撰写能力。</p>	gpgyhr@ime.ac.cn
高频高压中心	工艺工程师	微电子相关专业	<p>岗位职责：主要从事半导体光刻、材料生长、注入等相关工艺工艺开发，进行工艺方案制定、参数调试、保证工艺稳定性等工作。</p> <p>岗位要求：具备扎实的半导体物理和器件物理基础知识；熟悉半导体芯片制造流程；能够独立开展工艺的开发与优化工作；及时处理工艺异常，进行原因分析并制定解决方案；有相关从业经验者优先。</p>	gpgyhr@ime.ac.cn
高频高压中心	设备工程师	微电子、机械、自动化专业	<p>岗位职责：主要负责光刻、材料生长、注入等相关机台的维修维护，进行设备问题排查保养、和厂家工程师对接解决设备故障等工作。</p> <p>岗位要求：熟悉半导体生产设备的基本原理、结构与操作维护；具备机械原理、电路原理、电气控制等基础知识；能够快速诊断并给出设备故障解决方案。有相关从业经验者优先。</p>	gpgyhr@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
高频高压中心	工艺实验员	微电子相关专业	<p>岗位职责：主要从事半导体光刻、材料生长、注入等相关工艺工艺设备操作，开展工艺实验、数据记录、设备日常整理等工作。</p> <p>岗位要求：能够按照作业指导书正确使用工艺设备，准确记录工艺数据、填写生产记录、设备运行日志等；及时发现并终止工艺过程中的异常情况并上报；执行日常设备点检、清洁和简单保养工作，处理简单的设备报警；有相关从业经验者优先。</p>	gpgyhr@ime.ac.cn
通信中心	通信算法方向 博士后	通信与信息系统、信号与信息处理方向	<p>针对智能群体规模大，动态强，通信与控制挑战大、单一通信体制不能满足场景受限下复杂需求的问题，研究多制式自适应联合通信、有线无线融合网络的实时感知与性能优化和大规模分布式通信组网和资源协同调度控制，包括正交时空频调制技术、自适应高性能编码技术、多域索引调制技术、软件定义有线无线融合网络性能优化技术、弹性大规模分布式协同通信与分布式智能系统资源协同调度等关键技术。</p>	lijinhai@ime.ac.cn
通信中心	通感一体化系统研发与实现 工程师	电子与信息系统、信号与信息处理、通信与信息系统	<p>岗位职责： 1、根据指导从事下一代无线通信、感知、定位及通感一体化技术、智能反射面通信、毫米波/太赫兹通信及AI赋能通信与组网相关研究； 2、开展同感一体化原理样机试验验证； 3、完成相关科研项目研究、实验、仿真、申报、结题等工作，输出高质量论文专利等成果； 4、协助导师完成实验室建设、设备采购维护、项目申请等相关工作。</p> <p>岗位要求： 1. 通信、电子、计算机、数学等相关背景，以下方向优先考虑：6G无线通信、无线定位、通感一体化技术及AI赋能通信与组网等； 2. 具有扎实的专业背景知识、精通数学英语及熟练掌握至少一门编程语言，熟悉LaTex编辑工具； 3. 具有一定的项目参与经历。</p>	lijinhai@ime.ac.cn
通信中心	智能芯片研究员	计算机、通信、电子相关专业	<p>岗位职责： 1、研究基于Transformer架构的智能芯片架构，提升模型在端侧的推理效率； 2、发表高水平研究成果； 3、争取国家重大研究课题。</p> <p>岗位要求： 1、有智能芯片设计与研究经验； 2、发表过高水平论文。</p>	gaoxingyu@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
通信中心	类脑智能算法研究员	计算机、通信、电子相关专业	岗位职责： 1、研究类脑智能算法及软硬协同优化； 2、发表高水平研究成果； 3、争取国家重大研究课题。 岗位要求： 1、人工智能或类脑智能研究经验； 2、发表过高水平论文。	gaoxingyu@ime.ac.cn
通信中心	计算机视觉研究员	计算机、通信、电子相关专业	岗位职责： 1、研究各种复杂场景下的计算机视觉算法，提升模型的精度与鲁棒性等指标； 2、发表高水平研究成果； 3、争取国家重大研究课题。 岗位要求： 1、人工智能算法研究经验； 2、发表过高水平论文。	gaoxingyu@ime.ac.cn
EDA中心	器件TCAD仿真软件开发	数学、微电子学与固体电子学、物理学、材料学等理工专业	岗位职责： 1、开展器件TCAD软件研究与开发工作，包括器件TCAD基础建构、算法设计与优化、软件系统实现等。负责定制化TCAD仿真软件研发； 2、协助开展新材料/新器件/新架构下器件TCAD仿真软件原型设计等方向关键技术开发和积累，编写相关文档，撰写论文专利等； 3、完成领导交办的其他工作。 岗位要求： 1、理工类博士研究生毕业，具有丰富的微电子和集成电路领域的专业背景知识； 2、原则上年龄不超过45周岁，有主持集成电路相关平台软件研发项目的应聘者可适当放宽年龄限制； 3、有在知名科研机构高校或大型企业研发机构等担任教授/副教授或相当岗位的任职经历； 4、熟练掌握TCAD仿真软件开发流程及方法； 5、对新工艺TCAD研发工作具有创新意识，主动性与团队协作意识。	lizhiqiang@ime.ac.cn
EDA中心	器件建模与EDA技术	微电子学与固体电子学及相关专业	岗位职责： 负责新型工艺的先器件物理仿真、器件建模TCAD仿真，模型参数提取和晶体管级电路仿真。 岗位要求： 1、微电子学或计算机等专业，熟悉半导体物理和器件器件工作基本原理,如FinFET、FDSOI、CNTFET、GAA器件等； 2、熟悉集成电路制造工艺，熟悉TCAD仿真更佳； 3、熟悉Matlab等建模工具，熟练掌握Verilog-A语言； 4、熟悉器件模型参数提取的应用数学算法，具有器件模型提参项目经验者优先。	lizhiqiang@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
EDA中心	集成电路系统与工艺协同优化	集成电路、微电子学与固体电子学、物理学、材料学等理工专业	<p>岗位职责:</p> <p>1、开展集成电路系统与工艺的协同优化(DTCO/STCO)技术研究,包括电路系统架构与仿真、电路设计、器件与工艺协同优化;</p> <p>2、协助开展晶圆级三维系统电路设计与EDA技术等方向关键技术开发和积累;</p> <p>3、配合新型器件工艺的研发,开展设计协同优化技术研究,编写相关文档,撰写论文专利等;</p> <p>4、完成领导交办的其他工作。</p> <p>岗位要求:</p> <p>1、具有丰富的微电子和集成电路领域的专业背景知识;</p> <p>2、原则上年龄不超过45周岁,有主持系统级集成电路芯片设计项目的应聘者可适当放宽年龄限制;</p> <p>3、有在知名科研机构高校或大型企业研发机构等担任教授/副教授或相当岗位的任职经历;</p> <p>4、熟练掌握大规模系统芯片设计流程及方法;</p> <p>5、对STCO和EDA研发工作具有创新意识,主动性与团队协作意识。</p>	lizhiqiang@ime.ac.cn
EDA中心	SRAM设计与MemoryCompiler开发	集成电路、微电子学与固体电子学等理工专业	<p>岗位职责:</p> <p>SRAM设计, Memory Compiler开发。</p> <p>岗位要求:</p> <p>1、熟悉基本的存储器架构,熟悉存储单元,灵敏放大器、译码器等电路设计者更佳;</p> <p>2、熟悉全定制IC设计方法和流程,熟悉C、TCL、Python或Perl等任一中编程语言;</p> <p>3、熟悉HSPICE/SPECTRE/CustomSim中任一种晶体管级仿真工具;</p> <p>4、具有存储器芯片设计或Memory Compiler设计经验者优先。</p>	lizhiqiang@ime.ac.cn
设备中心	人工智能算法及模型工程师	计算机、微电子、人工智能、数学、统计学等相关专业	<p>岗位职责:</p> <p>1、参与半导体工艺相关的机器学习、深度学习、强化学习等人工智能算法的研究与设计;</p> <p>2、对算法模型进行持续优化,提升模型的准确性、效率和稳定性;</p> <p>3、完成领导交办的其他工作。</p> <p>岗位要求:</p> <p>1、计算机、微电子、人工智能、数学、统计学等相关专业,硕士及以上学历;</p> <p>2、熟练运用Python、C++等编程语言,熟悉 TensorFlow、PyTorch 等主流深度学习框架,深入掌握CNN、RNN、Transformer等机器学习、深度学习算法原理;</p> <p>3、具备实际AI项目开发经验者优先;</p> <p>4、有较强的创新精神和团队协作意识。</p>	yuanyan@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
设备中心	软件与控制系 统工程师	计算机、自动化、软件工程等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、参与系统总体设计，结合需求进行软件系统框架和模块的详细设计； 2、参与完成软件代码的详细设计、编写、集成与测试、发布以及相关技术文档的编写与整理工作； 3、完成领导分配的其它任务。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、计算机、自动化、软件工程等相关专业等相关专业，硕士及以上学历； 2、精通Linux及Windows操作系统下的界面变成以及驱动程序开发，可至少熟练使用一种主流编程语言，如Python/QT/C++/C#/Java等； 3、熟悉Unity3D/Unreal Engine等三维可视化设计软件、有相关项目经验者优先； 4、积极上进，具有高度的责任感和良好的团队协作精神。 	yuanyan@ime.ac.cn
设备中心	先进封装工艺 工程师	微电子、物理、材料等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、参与先进封装工艺的机理分析与工艺整合，辅助完成相关工艺的建模仿真； 2、参与相关工艺的方案制定与测试验证，以及相关设备的日常管理、维护和作业指导； 3、参与解决工艺开发中出现的各种问题； 4、完成领导分配的其它任务。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、微电子、材料、物理等相关专业，硕士及以上学历； 2、精通半导体物理、器件原理、先进封装技术，具有2年以上相关工艺开发经验者优先； 3、熟练使用TCAD/Sentaurus等工艺仿真工具者、熟悉Fab厂工艺流程或先进封装工艺者优先； 4、动手能力强、可独立解决问题，有良好的团队协作意识。 	yuanyan@ime.ac.cn
设备中心	机械工程师01	机械工程	<p>岗位职责：</p> <p>进行集成电路制造装备机械设计，工艺腔室内流体、加热温度均匀性、等离子体分布等与工艺相关参数计算优化；真空和流体等设备外购零部件性能比对和选型；与外协机加厂协作，保证外协加工部件质量。</p> <p>岗位要求：</p> <p>具备集成电路芯片制造知识，能够熟练使用三维设计软件进行机械设计，了解机械加工工艺，40岁以下，机械专业本科学历需5年以上相关工作经验。硕士以上学历，可以是应届毕业生。</p>	yuanyan@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
设备中心	半导体工艺研发/半导体智能设备开发工程师	微电子学、材料科学与工程、电子科学与技术、凝聚态物理等相关专业	<p>岗位职责： 半导体关键工艺技术研发与智能化设备开发。具体可包括： 1) 负责半导体关键工艺技术（如薄膜沉积、刻蚀、掺杂、封装等）的开发与优化，参与半导体核心设备的设计、研制与调试，解决设备工程化中的关键技术问题，推动工艺参数验证及设备系统性能提升； 2) 结合高性能、新材料、智能化、系统级架构创新等需求，开发新型物理实体与动态智能映射整合； 3) 主导实验设计及数据分析，撰写技术报告与专利文献，参与制定半导体工艺标准及技术路线，对接上下游团队，协同完成从工艺开发、设备验证到芯片制造的全链条技术攻关。</p> <p>岗位要求： 1) 专业背景：微电子学、材料科学与工程、电子科学与技术、凝聚态物理等相关专业硕士及以上学历（博士优先）； 2) 实践经验：硕士需具备半导体工艺开发或设备研制相关课题研究经历（如FAB厂实践、设备公司研发实习）；博士需在至少一项领域有深度积累，如工艺原理探索与设计仿真、设备控制系统开发、工艺缺陷分析、高精度工艺设计等，具有相关实验经历者优先； 3) 技术要求：熟悉半导体工艺流程与设备原理，掌握至少一种专业工具，具备数据分析能力，能熟练撰写英文技术文档，能独立完成实验设计与统计分析； 4) 综合素质：对半导体行业技术趋势敏感（如先进封装、化合物半导体），有攻克复杂工程问题的强烈意愿；具备跨学科协作能力，可适应高强度科研攻关节奏；善于沟通，良好协调能力和团队合作精神。</p>	yuanyan@ime.ac.cn
设备中心	激光应用系统集成技术工程师	光学、光学工程、电子科学与技术、半导体物理、凝聚态物理等相关专业	<p>岗位职责： 1、协助课题组开展基于光学方法的半导体器件缺陷表征及激光加工领域的研究工作； 2、协助课题组或独立申请国家科研项目； 3、协助课题组指导研究生的科研活动； 4、协助课题组开展相关设备集成及产业化方面的工作； 5、完成课题组安排的其他任务。</p> <p>岗位要求： 1、已获得或即将获得博士学位，具有光学（光学、光学工程、光电子）或半导体（半导体、微电子、集成电路）相关专业背景之一； 2、年龄不超过35周岁； 3、具有良好的实验动手能力、学习能力和沟通能力； 4、具备良好的英文文献阅读及论文撰写能力； 5、发表过高水平学术论文者优先，有海外学习和交流经历者优先。</p>	yuanyan@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
设备中心	电气工程师	电气相关专业	岗位职责： 1、负责设备的电气控制系统方案设计； 2、负责设备电气控制系统硬件部署、调试、测试； 3、提出控制调试软件需求，与软件工程师协同完成代码实现； 4、负责电气系统的现场安装和系统调试； 5、负责上位软件接口对接及合作开发； 6、负责设计文档编写归档。 岗位要求： 1、机械电子、传感与检测、自动化、控制工程、数学专业本科及以上学历； 2、2年以上运动产品相关行业工作经验，或具有相关项目经验的优秀应届硕士毕业生； 3、良好的控制理论基础，扎实的数学功底； 4、具有机器人，运动控制，无人机，运动台等MIMO系统设计调试经验； 5、熟练掌握MATLAB工具，熟悉C语言及控制算法实现； 6、精通MATLAB/Simulink，用MATLAB仿真模型，或其他基于模型设计工具及C/C++/HDL/Script代码生成工具者优先； 7、熟悉VME/PLC/PMAC/ACS等控制系统。	yuanyan@ime.ac.cn
设备中心	工艺工程师	微电子、物理、化学、材料	岗位职责： 项目研发装备的工艺实验及工艺开发；能够提出项目研发过程中关于工艺开发的工作思路，创新工艺实验的方法；能够开拓新的研究思路、解决项目研发中遇到得技术难题。 岗位要求： 集成电路设计、制造、封装、测试领域相关专业，以及物理、化学、材料等基础研究类相关专业，有志于从事集成电路领域研究工作的应届博士/硕士毕业生。有工作经验优先。	yuanyan@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
设备中心	电控工程师01	自动化	岗位职责： 1、负责设备的电气控制系统方案设计； 2、负责设备电气控制系统硬件部署、调试、测试； 3、提出控制调试软件需求，与软件工程师协同完成代码实现； 4、负责电气系统的现场安装和系统调试； 5、负责上位软件接口对接及合作开发； 6、负责设计文档编写归档。 岗位要求： 1、机械电子、传感与检测、自动化、控制工程、数学专业本科及以上学历，2年以上运动产品相关行业工作经验，或具有相关项目经验的优秀应届硕士毕业生，良好的控制理论基础，扎实的数学功底； 2、具有机器人，运动控制，无人机，运动台等IIM0系统设计调试经验，熟练掌握MATLAB工具，熟悉C语言及控制算法实现； 3、精通MATLAB/Simulink，用MATLAB仿真模型，或其他基于模型设计工具及C/C++/HDL/Script代码生成工具者优先； 4、熟悉VE/PLC/PMAC/ACS等控制系统。	yuanyan@ime.ac.cn
设备中心	系统工程师、光学工程师	光学、物理学、精密仪器及相关专业	岗位职责： 半导体光学微纳量测技术与仪器研制。具体可包括： 1) 仪器系统设计、2) 光学结构设计、3) 平台搭建、系统集成和数据分析、4) 相关应用和工艺开发和实验等。 岗位要求： (1) 光学、物理学、精密仪器及相关专业，硕士及以上； (2) 具有物理光学、精密仪器相关实验经验者优先； (3) 善于沟通，良好协调能力和团队合作精神。	yuanyan@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
封装中心	材料与电镀工艺研发工程师	微电子学、材料、化学工程、应用化学或相关交叉学科背景	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设计并实施系统化的电镀、刻蚀、清洗实验，评估工艺窗口； 2. 研究基板中深孔（TGV/TMV）与细线路电镀反应机理，建立电化学沉积的多场耦合模型，开展数值模拟与仿真； 3. 负责电镀液、酸碱蚀刻液及有机添加剂的性能表征与机理研究，建立体系化的药液分析手段，探索其与基板材料的作用机制，提出药液组成、配比与工艺条件的优化方法，保障沉积均匀性与可靠性； 4. 进行高水平的文献检索与信息整合，跟踪国内外最新研究进展。撰写技术报告、论文及专利申请。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专业技能：深入理解电化学沉积与微电子封装工艺机理，熟练掌握电化学测试手段（CV, EIS, ICP, UV-Vis 等）；熟悉模拟仿真工具（COMSOL Multiphysics、Ansys、MATLAB 等）进行电化学和多场耦合分析；掌握玻璃、有机膜等基板材料与药液的反应原理及优化路径； 2. 综合能力：较强的实验动手能力与问题解决能力，具备扎实的文献检索、归纳和科研写作能力，具有良好的英文阅读与技术交流能力（CET-6 或同等水平，SCI/专利写作经验优先）。有团队协作精神和跨学科沟通能力。 	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	玻璃改性与蚀刻工艺工程师	微电子学、材料、化学、应用化学、半导体工艺或相关交叉学科背景（如玻璃材料、表面处理与微细加工）	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工艺操作与设备管理。负责玻璃改性与蚀刻工艺设备的日常操作、维护和保养；定期进行设备状态检查，保证设备运行的稳定性和高效性；对设备进行故障排查，处理技术问题，并及时反馈与解决； 2. 工艺优化与方案制定。根据研发需求，独立完成新产品的工艺方案制定与实施；协同研发团队，优化工艺参数，提升产品性能与产出效率； 3. 文件体系建立与报告编写。建立和完善工艺报告、操作说明书及技术文档体系；编写详细的设备操作手册与维护指南，确保工艺与设备的规范操作；完成工艺数据的记录、分析和报告撰写，提供实验结果的准确反馈； 4. 团队协作与跨部门沟通。积极参与与研发人员的技术沟通，反馈工艺与测试结果；跨部门合作，确保工艺与设备调整与升级工作得到充分支持；向团队成员提供培训，分享工艺改进与操作经验。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专业技能：掌握半导体设备的操作与维护，了解相关光学、机械基本原理与化学药液配置和工艺控制；具备一定的 CAD 制图能力，能够进行工艺图纸的绘制与修改；具有较强的设备调试能力，能够快速响应并解决设备故障和工艺异常问题； 2. 综合能力：高效的沟通力、执行力和团队协作能力，良好的工艺文档编写能力； 3. 优先考虑：有化学药水的使用与管理经验，包括酸碱、表面活性剂及其他蚀刻添加剂的操作经验；熟悉玻璃改性设备或其他相近半导体工艺设备的常见故障和解决方法，具有相关设备维护与升级经验。 	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	树脂固化剂/电镀药水有机添加剂研发	有机合成、高分子合成等材料、化学背景	<p>岗位职责：</p> <p>研究新型高性能树脂固化剂及电镀药水有机添加剂的制备工艺。</p> <p>岗位要求：</p> <p>熟练掌握高分子与有机合成实验技能，具备丰富的材料测试表征经验。能够完成从文献调研、实验设计、样品制备、性能测试到数据分析与报告撰写的完整研发流程。</p>	yinwen@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
封装中心	先进软磁材料研发	微电子学与固体电子学、物理学、材料学等理工专业	岗位职责： 研究亚微米软磁粉体制备工艺。 岗位要求： 熟练掌握至少一种亚微米或纳米级高频软磁粉体制备工艺，了解电力电子用软磁材料磁化机理，能够依据具体需求独立开展软磁材料选型、制备与性能表征工作。	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	电源控制系统研发	电力电子、自动化、控制、数学等理工专业	岗位职责： 研究开关电源控制系统建模与实现方法。 岗位要求：熟练掌握非线性系统动态性能的时域、频域分析技术，熟悉非线性系统大信号分析的常用方法，能够依据具体需求独立开展控制方法与控制电路选型、设计与测试工作。	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	先进功率半导体器件研发	微电子学与固体电子学、物理学、材料学等理工专业	岗位职责： 设计高频低损耗功率半导体器件。 岗位要求：熟悉电压等级20V以下低压功率半导体器件基本结构与设计方法，具备相关功率器件流片经验，能够依托现有工艺平台独立研发面向低压大电流应用的高频功率半导体器件。	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	晶圆级键合技术研发	材料学、微电子学、机械自动化、物理学或其他相关专业	岗位职责： (1) 负责W2W或D2W晶圆级键合前瞻技术的研发或成套技术开发； (2) 负责研发项目立项、技术方案制定、开发计划制定、组建开发团队，以及项目的日常管理、各种技术的总结、归类和存档； (3) 负责与各站工艺工程师的日常工作协调，解决技术开发中出现的各种问题。 岗位要求： (1) 微电子、材料、物理等相关专业，博士学历，1-2年相关技术经验； (2) 熟悉晶圆级封装工艺、2.5D/3D集成技术； (3) 具有晶圆级键合技术工艺或设备研发经验优先。	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	晶圆级键合设备工程师	机械、自动化、机电或其他相关专业	岗位职责： (1) 负责W2W或D2W晶圆级键合设备关键模块研究； (2) 负责研发项目工艺方案制定与验证，以及相关设备的日常管理、维护和作业指导； (3) 负责解决晶圆级键合工艺开发中出现的各种设备问题。 岗位要求： (1) 机械、自动化、机电等相关专业，硕士及以上学历，2年以上相关技术经验； (2) 具有晶圆级键合技术工艺或设备研发经验优先。	yinwen@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
封装中心	化学气相沉积(PECVD)工艺工程师	材料学、化学、微电子学、物理学或其他相关专业	岗位职责： (1) 负责化学气相沉积工艺技术开发； (2) 负责研发项目工艺方案制定与验证，以及相关设备的日常管理、维护和作业指导； (3) 负责解决化学气相沉积工艺开发中出现的各种问题。 岗位要求： (1) 化学、微电子、材料、物理等相关专业，本科及以上学历，2年以上相关技术经验； (2) 熟悉晶圆级封装工艺、2.5D/3D集成技术； (3) 具有化学气相沉积工艺或设备研发经验优先。	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	计算电磁学研究	电子与电气工程、电磁场与微波技术、雷达技术、计算机科学、数学、物理学等	岗位职责： 1. 电磁场算法的底层架构； 2. 先进封装参数提取场景核心算法设计。 岗位要求： 1. 申请人已经获得或即将获得国内外高校电子与电气工程、电磁场与微波技术、雷达技术、计算机科学、数学、物理学等学科博士学位，获得博士学位时间不超过3年。年龄一般不超过35岁； 2. 具有电磁场数值分析、工业软件开发、集成电路设计仿真等方面的教育和研究背景，精通高频电磁场的某类算法，例如：FEM、MOM 等基础算法原理，热爱科学研究，具有探索能力和团队合作精神； 3. 具备独立开展科研的能力，有发表高水平论文经验，或技术能力特别优秀的申请人优先考虑。	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	热设计工程师	电子封装、工程热物理、材料相关专业	需招聘电子封装热设计工程师2名，35岁以下，具有电子封装、工程热物理、材料相关研究背景，研究方向涵盖三维堆叠热管理、微纳尺度热传导或热界面材料领域，有分子动力学计算、第一性原理计算、微纳尺度热测试、热界面材料制备或界面键合研究经历者优先考虑。	yinwen@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
封装中心	工艺研发工程师	微电子学 / 半导体器件与工艺 / 材料科学与工程 / 集成电路工程 / 先进封装工程或相关交叉学科背景	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责基板相关工艺中的一项或几项（如光刻、蚀刻、电镀、成孔等）工艺的研究、分析与优化； 从结构设计、材料特性及制程参数等角度，系统分析工艺问题并提出改进方案； 独立或协同完成工艺实验设计、实施与结果验证，解决制程中的关键技术问题； 参与新工艺、新结构或新产品的工艺方案制定与导入； 对工艺数据进行整理、分析与总结，编写工艺报告、技术文档和标准操作说明； 与设计、设备、测试等团队密切配合，推动工艺持续改进。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 对基板工艺流程具有一定理解，熟悉典型半导体或封装制程；具备从材料、结构和工艺参数层面分析和优化工艺的能力；具备较强的实验动手能力，能够独立开展工艺验证和问题排查；熟悉常见制程问题分析方法（如 DOE、失效分析、工艺窗口评估等）。； 具备较强的问题解决能力，能够快速定位并解决工艺异常；具备良好的技术总结与报告编写能力，逻辑清晰、表达规范；具备良好的沟通能力和团队协作意识，能跨部门协同推进项目；工作踏实、执行力强，具备持续学习与技术积累能力。 优先条件：有基板、载板、晶圆级或面板级工艺开发经验；有先进封装、2.5D/3D 集成、玻璃或有机基板相关经验；有工艺导入、良率提升或量产支持经验者优先。 	yinwen@ime.ac.cn
封装中心	材料研发	无机非金属材料 / 材料科学与工程（玻璃、陶瓷方向） / 微电子科学与工程（材料与封装相关方向） / 凝聚态物理 / 应用物理（偏结构与机理研究）或相关交叉学科背景（如玻璃材料、微结构与多物理场）	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展玻璃材料微观结构及其演化机理研究，分析微观结构与材料性能之间的关联关系； 结合实验与理论方法，建立玻璃材料结构分析与数值模拟模型，开展多尺度仿真研究； 参与玻璃材料相关实验设计、实施与数据分析，推动研究成果验证与优化； 跟踪国内外研究进展，开展系统性文献调研与技术总结； 参与科研项目申请、技术路线论证及阶段性研究报告编写； 协同团队完成科研任务，支撑论文发表、专利布局及对外技术交流。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 材料科学、无机非金属、微电子或相关专业背景； 熟悉玻璃材料微观结构及其结构-性能关系，具备相关理论基础； 具备材料分析与数值模拟/仿真能力，能够开展结构建模与机理分析； 具备较强的实验动手能力和问题分析能力； 具有良好的文献检索、整理与科研写作能力，能参与项目申请及技术报告编写； 具备较高的英文文献阅读能力，能够跟踪国际研究进展； 工作积极主动，具备良好的沟通能力与团队协作意识。 	yinwen@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
封装中心	化学反应机制与动力学模拟研发	材料科学与工程 / 应用化学 / 物理化学 / 化学工程 / 无机非金属材料 / 微电子科学与工程等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统研究基材（如硼硅酸盐、铝硅酸盐、磷酸盐等体系的网络结构特征等）成分结构建模与表征及其与酸液、碱液及功能性添加剂之间的反应机理与动力学行为； 2. 从化学反应、传质/扩散及界面作用等角度，分析玻璃腐蚀、改性或溶蚀过程；建立基材—化学液相反应的理论模型与数值仿真方法与参数优化； 3. 设计并实施相关实验，验证模型与工艺假设； 4. 开展系统性文献调研，跟踪国内外前沿研究进展； 5. 参与科研项目申请、技术路线论证及阶段性研究报告、技术文档的编写； 6. 支撑论文发表、专利布局及跨团队技术交流。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 硕士及以上学历（博士优先），材料科学、无机非金属、化学工程、应用化学、微电子或相关专业背景； 2. 熟悉玻璃结构与物化特性，理解酸碱蚀刻反应原理 熟练掌握一种以上仿真工具（COMSOL、Fluent、Chemkin、Matlab等），具有反应动力学建模经验者优先； 3. 熟悉材料分析方法（如XPS、ToF-SIMS、ICP-OES、FTIR、Raman）者优先； 4. 有材料反应机制研究项目或论文成果者优先考虑。 	yinwen@ime.ac.cn
先导中心	纳米CMOS器件及集成工艺研发	微电子学与固体电子学及相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 负责CFET器件关键工艺、集成技术研发； 2. 负责高迁移率沟道器件、异质CFET等新型器件及集成技术研发； 3. 负责纳米器件电学特性测试分析及优化； 4. 参与相关科研项目申请、报告、结题等工作。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电子类相关专业，硕士及硕士以上学历； 2. 工作态度认真负责，做事积极主动，具有较强沟通、学习和动手能力，工作认真负责、善于学习、具有良好的团队合作精神； 3. 对半导体器件和工艺有深入的理解，熟悉纳米CMOS集成工艺，具备CMOS器件电学性能分析和优化能力； 4. 有半导体器件和工艺研发经验者优先。 	icachr@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
先导中心	先进技术节点器件可靠性研究	集成电路工程、信息与电子科学、物理、电子科学与技术、化学、材料等	岗位职责： 1. 开展先进技术节点器件的可靠性表征与机理分析工作； 2. 开展先进技术节点器件的失效分析工作； 3. 完成项目申报、执行和结题的部分技术总结工作； 4. 协助指导硕士/博士研究生。 岗位要求： 1. 微电子、物理和材料相关专业，博士学历； 2. 熟先进逻辑器件的工艺集成技术； 3. 具备半导体器件物理和集成工艺基础； 4. 具有良好的英语听说读写能力； 5. 具有半导体器件测试相关经验者优先。	icachr@ime.ac.cn
先导中心	光IO集成技术研究	光电集成相关专业	岗位职责： 1. 跟踪硅光集成技术在光互连应用的趋势和前沿技术，开展光IO集成芯片研究，包括使用光电设计软件进行硅光收发芯片的链路仿真设计，硅光芯片的集成封装和测试，研制出光IO原型样品； 2. 参与硅光新材料、新工艺、新器件研究； 3. 参与硅光项目申请。 岗位要求： 1. 具有光电技术相关专业博士学位； 2. 能熟练使用光电设计仿真软件工具； 3. 工作态度积极，责任心强，能负责申请和承担国家研究课题； 4. 流利的英语读写能力。	icachr@ime.ac.cn
先导中心	光电集成芯片特别研究助理	光电子	岗位职责： 1. 负责面向光通信、光计算、量子计算、先进光电共封的光电集成芯片与光电封装研发； 2. 负责跟踪光电集成芯片、器件、光电共封的发展趋势和前沿研究，负责或参与高速光电子器件的理论分析、设计、版图、工艺制备、测试； 3. 参与相关科研项目申请与实施； 4. 参与指导硕博研究生。 岗位要求： 1. 博士学位，EE及光电子等相关专业，35岁以下； 2. 有SOI无源或高速光器件与芯片设计与流片经历，有光计算/硅光调制器/TFLN调制器研究经历优先； 3. 熟悉Lumerical等光电子仿真设计软件及版图软件； 4. 工作态度积极，责任心强，执行力强，能独立承担研究课题的主要研究任务； 5. 流利的英语读写能力，发表过SCI期刊论文。	icachr@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
先导中心	三维硅基MOSFET器件集成	微电子相关专业	岗位职责： 1. 开展三维器件集成研发，包括结构设计、仿真、制备及测试分析； 2. 把握国内外研究现状和发展趋势，申报所属领域的科研项目； 3. 参与相关项目的研究工作，撰写相应科研报告，并在重要学术期刊上发表高水平论文； 4. 指导和协助指导研究生。 岗位要求： 1. 博士研究生毕业，具备半导体物理等相关知识背景； 2. 具有集成电路制造集成经验，尤其是硅基MOS器件工艺基础； 3. 掌握器件仿真、参数及特性分析的相关软件的使用，并能完成相关测试分析； 4. 能利用外语独立开展国际交流，具备撰写出较高水平的研究报告或发表过较高学术价值的论文的能力。	icachr@ime.ac.cn
先导中心	二维半导体材料与器件研发	材料科学、微电子相关专业	岗位职责： 1. 开展二维半导体（TMDs等）晶圆级生长； 2. 晶圆级二维半导体器件工艺研究； 3. 撰写相应科研报告，并在重要学术期刊上发表高水平论文； 4. 指导和协助指导研究生。 岗位要求： 1. 博士研究生毕业，具备半导体物理、材料科学、或微电子器件等相关知识背景； 2. 具有二维材料生长或器件工艺相关研究经历； 3. 熟悉掌握微电子器件表征、测量和相关实验结果分析等方面的知识； 4. 能利用外语独立开展国际交流，具备撰写出较高水平的研究报告或发表过较高学术价值的论文的能力。	icachr@ime.ac.cn
先导中心	硅基传感器技术研发	微电子、集成电路、半导体、电子信息技术、光电子、物理、材料	岗位职责： 硅基传感器技术研发 岗位要求： 具有一定的半导体传感器、半导体物理与器件及工艺知识基础，具备科研项目研发经验或者工艺线流片经验，拥有较强科研兴趣和钻研潜质，踏实勤奋。	icachr@ime.ac.cn
先导中心	顺序CFET器件与三维集成研发	微电子与固体电子学、集成电路科学与工程、半导体材料等	岗位职责： 协助合作导师完成xxx项目、国家重国家重点研发计划金等国家级重要科研项目，围绕先进顺序三维集成结构与集成技术开展创新性研究工作，争取在高水平学术期刊（如 VLSI, IEDM, IEEE EDL/TED等）和顶级国际会议上发表高水平学术论文；积极申请国家发明专利和国际专利。 岗位要求： 已获得或即将获得微电子、电子科学与技术、集成电路科学与工程、材料等相关专业的博士学位，获学位时间一般不超过3年。具备半导体物理与器件扎实基础，有微纳加工工艺（如光刻、刻蚀、薄膜、扩散）实验经验者优先；熟练使用TCAD（如Sentaurus, Silvaco）仿真工具者优先。	icachr@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
先导中心	前段工艺整合工程师	集成电路制造、微纳加工、光学工程、材料学、等离子体物理、化学、机械	岗位职责： 1. 负责集成电路前段整合工艺设计与开发、流片与电学测试，分析、解决流片过程中遇到的各类工艺、器件结构、电学特性等异常问题；撰写研发报告； 2. 完成部门领导布置的其他任务； 3. 完成部门领导布置的其他任务。 岗位要求： 1. 熟悉集成电路版图设计、制造工艺（晶体管制造）与电学测试； 2. 具有较强逻辑思维能力和独立分析问题、解决问题能力； 3. 工作认真负责，具有较好的团队合作能力和协同沟通能力； 4. 可以查找、阅读英文文献，具有较强的文字表达能力； 5. 具有一定工作经验更佳。	icachr@ime.ac.cn
先导中心	后段工艺整合工程师	集成电路制造、微纳加工、材料学、等离子体物理、化学、机械	岗位职责： 负责集成电路后段整合工艺设计与开发、流片与电学测试，分析、解决流片过程中遇到的各类工艺、器件结构、电学特性等异常问题；撰写研发报告。 岗位要求： 1. 熟悉集成电路版图设计、制造工艺（铜金属互连）与电学测试； 2. 具有较强逻辑思维能力和独立分析问题、解决问题能力； 3. 工作认真负责，具有较好的团队合作能力和协同沟通能力； 4. 可以查找、阅读英文文献，具有较强的文字表达能力； 5. 具有一定工作经验更佳。	icachr@ime.ac.cn
先导中心	超平坦化工艺研发工程师	集成电路制造、微纳加工、材料学、等离子体物理、化学、机械	岗位职责： 1. 负责超平坦化工艺开发、短流程流片与超平表面测试表征方法研究等； 2. 分析、解决工艺开发过程中遇到的各类工艺问题；撰写研发报告； 3. 完成部门领导布置的其他任务。 岗位要求： 1. 熟悉化学机械平坦化工艺、干法刻蚀工艺以及扫描电子显微镜、原子力显微镜、激光干涉仪等物理表征手段； 2. 具有较强逻辑思维能力和独立分析问题、解决问题能力； 3. 工作认真负责，具有较好的团队合作能力和协同沟通能力； 4. 可以查找、阅读英文文献，具有较强的文字表达能力； 5. 具有一定工作经验更佳。	icachr@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
先导中心	湿法工艺研发工程师	集成电路制造、微纳加工、材料学、化学	岗位职责： 1. 负责面向新工艺应用的湿法工艺开发、配方型化学液研制以及超高精度金属痕量检测方法研究等； 2. 分析、解决工艺开发过程中遇到的各类工艺问题； 3. 撰写研发报告； 4. 完成部门领导布置的其他任务。 岗位要求： 1. 熟悉化学湿法腐蚀、清洗工艺以及电化学分析仪、二次离子质谱、傅里叶红外光谱等材料组分、结构表征手段； 2. 具有较强逻辑思维能力和独立分析问题、解决问题能力； 3. 工作认真负责，具有较好的团队合作能力和协同沟通能力； 4. 可以查找、阅读英文文献，具有较强的文字表达能力； 5. 具有一定工作经验更佳。	icachr@ime.ac.cn
先导中心	干法刻蚀研发工程师	集成电路制造、微纳加工、材料学、等离子体物理、化学、机械	岗位职责： 负责面向新工艺应用的干法工艺开发。分析、解决工艺开发过程中遇到的各类工艺问题；撰写研发报告。完成部门领导布置的其他任务。 岗位要求： 熟悉干法刻蚀、结构表征手段；具有较强逻辑思维能力和独立分析问题、解决问题能力；工作认真负责，具有较好的团队合作能力和协同沟通能力；可以查找、阅读英文文献，具有较强的文字表达能力。具有一定工作经验更佳。	icachr@ime.ac.cn
健康电子中心 数字健康实验室	算法工程师	微电子学与固体电子学等相关专业	岗位职责： 1、负责脉诊微弱信号检测力学传感器、多通道并行处理芯片以及相关设备的研发； 2、负责多模态信号处理和人体状态评估建模； 3、面向6G通感融合，基于UWB技术，开发人体定位和微弱信号捕捉算法； 4、参与国家、省市级项目撰写、申报以及结题相关工作。 岗位要求： 1、微电子学与固体电子学相关专业； 2、年龄38岁以下； 3、具有6年及以上脉搏波检测及应用算法开发经验； 4、作为项目负责人，参与项目不少于1项，且项目金额不低于70万； 5、熟练掌握MATLAB, C、python等开发语言； 6、具有良好的品行、团队合作精神、强烈的责任心； 7、具备较好的写作能力，具有相关芯片、算法项目实施经验者优先。	lilie@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
AI中心	人工智能芯片研发岗	计算机科学与技术、电子科学与技术、微电子学与固体电子学、集成电路工程、人工智能、模式识别与智能系统等相关专业	岗位职责： 1. 开展新型架构AI芯片研发； 2. 参与国家级科研项目，产出顶会论文，培养研究生； 3. 加强学术/产业界交流。 岗位要求 （一）基本要求 博士学位，顶会/顶刊一作或通讯论文≥5篇；或者拥有关联核心专利； 年龄不超过38周岁（国家级人才项目主持者可放宽至40周岁）； 具有 AI 芯片研发项目管理经验者论文数量可放宽。 （二）核心技能 1. 精通AI模型算法原理与硬件需求，熟悉AI芯片架构，掌握算子-硬件映射方法； 2. 精通深度学习框架，掌握C/C++，了解Verilog/VHDL基础。	chenxiaolin@ime.ac.cn
AI中心	人工智能芯片架构研发岗	计算机科学与技术、电子科学与技术、微电子学与固体电子学、集成电路工程、人工智能、模式识别与智能系统等相关专业	岗位职责： 1. 开展面向大模型、计算机视觉、生成式AI等新型架构加速器研究； 2. 参与国家级科研项目，产出顶会论文，跟踪AI算法与芯片架构顶会动态，开展前沿技术预研，协助培养研究生。 岗位要求 （一）基本要求 博士学位，顶会/顶刊一作论文≥2篇；或者拥有关联核心专利，年龄不超过33周岁。 （二）核心技能 1. 精通AI模型算法原理与硬件需求，熟悉AI芯片架构设计方法； 2. 熟练使用GPU/Gem5性能分析工具，能定位并解决性能瓶颈； 3. 熟练使用SystemC/Gem5/GPGPU-Sim等平台进行架构仿真和设计； 4. 精通深度学习框架，掌握C/C++，了解Verilog/VHDL基础。	chenxiaolin@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
AI中心	计算机存储系统架构研发岗	计算机科学与技术、电子科学与技术、微电子学与固体电子学、集成电路工程、人工智能、模式识别与智能系统等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展高带宽三维存储架构及系统相关研究工作； 2. 前沿技术预研与科研产出：参与国家级科研项目，撰写高水平学术论文； 3. 跟踪存储系统及架构领域顶会； 4. 协助指导研究生，申请存储架构相关专利。 <p>岗位要求：</p> <p>（一）基本要求</p> <p>博士学历，顶会/顶刊一作论文≥2篇；或者拥有关联核心专利；年龄不超过33周岁。</p> <p>（二）核心技能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 深入掌握DDR系列协议的时序规范、信号定义； 2. 理解存储一致性协议的原理与实现逻辑； 3. 能独立完成存储阵列架构方案设计与参数仿真； 4. 熟练使用存储架构仿真/设计工具，如Ramulator/Gem5/SystemC/Verilog/VHDL/Cadence Virtuoso等； 5. 精通Python/C/C++编程语言，能开发存储性能测试工具、协议验证脚本或存储管理系统核心模块代码； 6. 熟悉存储管理系统核心机制，Linux存储子系统者优先。 	chenxiaolin@ime.ac.cn
AI中心	数字芯片设计研发岗	计算机科学与技术、电子科学与技术、微电子学与固体电子学、集成电路工程等相关专业。	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 负责AI芯片FPGA原型开发与验证，含RTL移植、逻辑综合、时序优化及功能仿真，支撑流片前功能与性能评估； 2. 主导SoC系统级调试，覆盖RISC-V/ARM核、PCIe/DDR/SPI接口及AI加速模块，解决硬件逻辑、协议兼容、时钟同步问题； 3. 负责AI模型嵌入式部署（边缘端AI芯片/FPGA加速板）； 4. 编写技术文档。 <p>岗位要求：</p> <p>（一）基本要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 硕士以上学历，年龄原则上≤40周岁，特别优秀者可放宽； 2. 3年及以上芯片研发经验，至少主导过1个FPGA原型验证或AI芯片集成项目； 3. 有边缘端AI芯片部署或RISC-V/ARM架构SoC设计调试经验优先。 <p>（二）核心技能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 精通Verilog/VHDL，熟练使用Xilinx Vivado、Intel Quartus，掌握UVM/SystemVerilog验证方法学； 2. 熟悉SoC架构，掌握RISC-V/ARM Cortex核、UART/I2C/SPI外设机制，会用JTAG调试器/逻辑分析仪/示波器定位时序违规、协议异常； 3. 熟练使用ModelSim/VCS仿真工具、PrimeTime性能分析工具； 4. 有DDR4、PCIe高速接口FPGA实现与调试经验，有AI芯片相关专利或顶会/顶刊论文者优先。 	chenxiaolin@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
AI中心	人工智能算法研发岗	计算机科学与技术、人工智能、模式识别与智能系统、电子信息工程、数学与应用数学等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责大模型、计算机视觉等算法工程化部署； 优化模型的部署性能，降低推理延迟、提升硬件资源利用率； 跟踪NeurIPS/ICML/CVPR/ICLR等顶会顶刊； 编写部署手册、优化报告等文档。 <p>岗位要求：</p> <p>（一）基本要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历；博士在大模型/计算机视觉/生成式AI领域有专项研究成果者优先； 年龄：硕士≤35 周岁并有2年以上AI算法工程经验，博士≤40周岁；有核心算法部署经验或头部AI企业资深经历者可放宽； 边缘端模型轻量化、大模型分布式推理、AIGC工业化应用经验者优先。 <p>（二）核心能力要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 精通AI 模型原理与架构，熟悉TensorRT/ONNX Runtime/vLLM等部署工具链，掌握多硬件平台部署特性，了解Docker容器化技术； 熟悉模型量化、剪枝、算子优化技术，熟练使用Nsight/Perf等工具； 扎实AI算法基础，能快速分析顶会论文创新点，分析复现算法； 精通Python+AI框架，掌握Pandas/NumPy/OpenCV数据处理工具，了解C/C++。 	chenxiaolin@ime.ac.cn
AI中心	存储芯片设计工程师	电子科学与技术、微电子学与固体电子学、集成电路工程、半导体器件等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责SRAM等存储阵列设计，制定架构方案，完成单元电路设计、布局规划及参数优化； 开发存储阵列编译脚本，搭建调试环境，定位问题； 主导数模混合模块集成，保障系统兼容性； 制定存储宏单元验证方案，开展功能、时序及可靠性验证，编写报告。 <p>岗位要求：</p> <p>（一）基本条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 硕士及以上学历；年龄：硕士≤35周岁，博士≤40周岁（核心技术骨干或头部芯片企业资深经验者优先放宽）； 工作经历：至少参与1个完整存储阵列设计项目； <p>博士有存储电路顶刊/专利者优先；有SRAM或数模混合集成经验者优先。</p> <p>（二）核心技能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 精通 SRAM 等存储单元原理，掌握存储阵列架构设计，能独立完成电路设计与仿真； 熟练使用Cadence Virtuoso等设计工具，具备版图规划与寄生参数分析能力； 会用Python/Tcl编写自动化脚本，熟练操作示波器、逻辑分析仪等调试设备； 掌握数模接口隔离、信号完整性优化技术，熟悉运算放大器、参考源等模拟模块； 能使用Spectre/HSPICE开展仿真，具备LVS/DRC/ERC后仿真经验。 	chenxiaolin@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
AI中心	仿真加速器软件研发岗	全日制硕士以上学历，计算机科学与技术、计算机软件与理论、软件工程、电子科学与技术等相关专业。	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责仿真平台的EDA工具软件开发，包括仿真器、调试器、图分割算法、调度与映射算法等； 参与仿真编译器的架构设计与开发，并结合前沿技术提供高性能编程解决方案； 负责开发仿真平台的运行时系统软件； 负责构建仿真平台的测试用例。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 计算机、软件相关专业硕士及以上学历，具有算法和数据结构设计经验； 对计算机体系结构有深入理解，熟悉编译原理及其算法实现； 有 C/C++ 语言开发经验，GCC、LLVM 或其他编译器开发经验者优先； 有Linux 驱动或嵌入式系统开发经验，有PCIe相关协议开发经验者优先； 有 Verilog、SystemVerilog、VHDL或者Chisel等硬件描述语言使用经验者优先； 具有软件测试方法的经验。 	chenxiaolin@ime.ac.cn
AI中心	仿真加速器硬件研发岗	全日制硕士以上学历，计算机科学与技术、电子科学与技术、通信工程、微电子学与固体电子学、集成电路工程等相关专业。	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 开发基于 FPGA 原型系统的参考设计； 负责FPGA逻辑架构方案、子模块详细方案设计 & 验证方案设计及优化； 承担FPGA各类通用模块的RTL代码开发或模块验证，实现计算核、cache、内存控制器、各类算法、各类高速接口协议、各类通信协议的逻辑产品交付； 负责硬件FPGA创新设计，聚焦处理器、内存、网络、AI等芯片的体系架构创新。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 通信、电子、自动化、计算机、集成电路等相关专业本科及以上学历； 至少 2 年以上的 RTL 设计经验，熟悉以下一门或多门语言：Verilog、SystemVerilog、Chisel或其他硬件描述语言； 熟悉器件特性(Xilinx、Altera器件等)，熟悉Vivado、Quartus等电路后端工具，熟悉VCS、Verdi等逻辑仿真工具； 满足以下任一条件者优先： <ol style="list-style-type: none"> 有扎实的数电功底或对数字电路兴趣浓厚； 熟悉一种或多种常用接口或通信协议 (AXI、PCIe、I2C、Serdes、DDR、CAN等)； 了解高速设计、异步设计、仿真方法学等高端逻辑技术； 了解 FPGA 原型设计分割技术，熟悉商业 FPGA 分割工具的使用，同时也有手动分割复杂 SoC 设计到多颗 FPGA 的经验； 参加全国电子设计竞赛、研究生电子设计竞赛、挑战杯等，有相关竞赛经验。 	chenxiaolin@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
AI中心	AI软件系统工程师	计算机科学与技术、人工智能、软件工程等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 研究面向大模型和AI芯片（如GPU或下一代AI芯片）的软件栈技术包括但不限于大模型算子、AI编译器、推理框架、分布式框架、量化方法、强化学习框架等。 2. 开发相应的软件项目，通过开源或社区合作的方式产生工业级影响力。 3. 发表顶级学术论文或申请专利。 <p>岗位要求：</p> <p>（一）基本要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 硕士学历需具备2年及以上AI软件相关工作经验 2. 熟练掌握C/C++/Python等至少一门编程技能，有扎实的编程基础 3. 了解至少一款GPU或AI芯片架构，并有关编程经验 4. 对大模型或其他AI模型的计算负载有基本了解 <p>（二）其他要求（有一下任意一项经验者优先考虑）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在AI系统领域发表过顶级学术论文； 2. 熟悉GPU或其他AI芯片上算子编程与优化（如CUDA, Cutlass, Cute, Triton, TileLang等）； 3. 熟悉一项或多项AI软件栈技术或框架：如Torch.compiler, Triton, TileLang, vLLM, SGLang, MLIR, TVM, XLA, Pytorch, TensorFlow, ONNX等； 4. 熟悉主流模型架构及相关算子优化技术（如FlashAttention、FlashMLA、DeepEP等）； 5. 熟悉NCCL或类似通信编程技术，或者有过分布式和异步编程经验； 6. 有超算或并行编程经验（如熟悉分布式矩阵乘法、MPI等）； 7. 有其它AI芯片的算子开发、模型优化、低精度量化、部署经验者。 	xuejilong@ime.ac.cn
AI中心	SIPI工程师	计算机科学与技术、人工智能、软件工程等相关专业	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3D封装芯片，高速IP和电源系统级SIPI设计优化仿真； 2. SIPI仿测一致性研究； 3. 追踪SIPI相关领域最新研究和工程进展，持续优化工作流程，建立优化仿真方法学； 4. 跨团队合作，对项目中实际SIPI问题进行定位和解决。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电子通讯或天线微波等相关专业，研究生学历5年+工作经验； 2. 深入理解SIPI相关工作流程，精通设计和仿真原理，熟练使用业界常用软件（sigrity, clarity, HFSS, ADS, hspice等），深入理解SIPI仿真方法； 3. 精通3D建模，熟悉2.5D封装结构（interposer, RDL等），熟悉常用材料特性，了解封装和PCB制造； 4. 熟练使用常用测试仪器（oscilloscope, VNA, TDR等），对仿测一致性有深入理解； 5. 有较强学习能力，有责任心，重视工作细节。有较强沟通能力，有跨部门合作能力； 6. 有C语言或脚本编程能力优先。 	xuejilong@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
光电中心一组	光学设计工程师01	光学类专业、光学工程	<p>岗位职责：</p> <p>(1) 负责精密光学设计和微纳检测技术研究，包括照明光学系统设计、光束匀化整形、偏振调制、纳米级特征光学衍射/散射仿真等；</p> <p>(2) 复杂光学系统搭建与装调、光学器件选型与采购；</p> <p>(3) 撰写技术报告、调研相关英文文献；</p> <p>(4) 上级安排的其它任务。</p> <p>岗位要求：</p> <p>(1) 熟练使用Zemax或CodeV等光学设计软件；熟练使用Matlab数据分析工具；</p> <p>(2) 具有扎实的工程光学理论基础；能够熟练使用英文进行文献查阅、文章撰写；</p> <p>(3) 具有光学设计经验、光机一体化设计和系统调试经验者优先；</p> <p>(4) 做事踏实细心、积极主动、认真负责。</p>	yaoyu2020@ime.ac.cn
光电中心一组	光学测量及软件研发工程师	仪器科学与技术类、光学工程类、计算机科学与技术类、软件工程类专业	<p>岗位职责：</p> <p>激光跟踪与姿态测量、激光跟踪仪组网测量、软件研发、模型设计、测量流程设计与实现。</p> <p>岗位要求：</p> <p>(1) 具备扎实的数学功底，掌握几何量测量基本理论知识，系统学习过机器视觉、误差理论、机器人运动学、光电检测技术等课程且成绩优秀者优先；</p> <p>(2) 具有较强的编程实操能力，能够熟练使用C/C++，c#，Python等语言进行项目开发，熟悉OpenCV、Qt、VTK、tensorflow、pytorch等框架；</p> <p>(3) 在公开数据集或软件系统开发方面取得显著成绩或具有丰富开发经验者优先；</p> <p>(4) 具有良好的沟通表达和问题分析能力，独立或主导过软件应用需求分析、软件文档编制者优先。</p>	yaoyu2020@ime.ac.cn
光电中心一组	嵌入式开发工程师	信息与电子科学类、控制科学与工程类、光学工程类	<p>岗位职责：</p> <p>(1) 嵌入式硬件开发、新型嵌入式架构设计及优化；</p> <p>(2) 数据采集及信息综合处理；</p> <p>(3) 高速测距及图像信息处理及算法实现。</p> <p>岗位要求：</p> <p>(1) 熟练掌握至少一种常用的PCB设计软件，能够独立进行电路设计；</p> <p>(2) 掌握信号处理理论与方法，具有较为扎实的嵌入式软硬件设计、调试及开发经验；</p> <p>(3) 熟练掌握C、Verilog硬件编程语言，具有一定的FPGA或GPU或DSP应用经验；</p> <p>(4) 具有高速信号处理、激光测距开发经验者优先；</p> <p>(5) 具有较强的学习能力和责任心，具有团队合作精神和良好的沟通能力。</p>	yaoyu2020@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
光电中心一组	综合测试工程师	光学类、光学工程、信息与电子类、自动控制类	岗位职责：岗位职责： (1) 仪器综合测试方案规划，坐标、测量姿态参数标定，仪器测量方法研究； (2) 电路PCB绘制与改进、高速电路板性能评估与测试； (3) 精密转台测试、转台热学仿真测试、光栅测角性能评估； (4) 激光器、准直器件、耦合器件、光学部件高效测试方法与工艺研究。 岗位要求： (1) 具有光学工程、仪器科学与技术、电子科学与技术、自动控制等相关专业背景； (2) 具有较好的动手能力，能够熟练使用数据分析软件用MABLAB, C/C++等； (3) 上述条件符合两条以上，具有测试系统开发经验者优先。	yaoyu2020@ime.ac.cn
光电中心二组	真空设备工程师	真空工程、机械设计、过程工程	岗位职责： 1) 真空设备系统设计、机械设计及力学仿真； 2) 机械出图及生产跟踪； 3) 真空系统稀薄流场仿真分析。 岗位要求： 1) 35周岁以下； 2) 硕士及以上学历； 3) 真空工程及相关专业； 4) 非应届生需具有真空设备研发经历不少于3年，应届生不限工作经历； 5) 掌握真空物理、真空测量、真空获得、真空材料、真空工艺、真空系统设计等基础理论，熟练开展真空系统三维绘图，能开展真空系统力学性能仿真分析，能利用软件开展真空系统流场仿真。	hanxuerong@ime.ac.cn
光电中心二组	光学工程师01	光学工程、光学、仪器科学与技术、物理及相关专业	岗位职责： (1) 负责精密光学系统的方案设计与最新技术的跟踪研究； (2) 负责精密光学系统总体设计与仿真建模，文档撰写； (3) 负责精密光学系统集成、测试与分析。 岗位要求： (1) 熟练掌握光学系统设计仿真相关理论基础； (2) 光学工程、光学、仪器科学与技术、物理及相关专业； (3) 熟练使用光学设计仿真软件（如Zemax, CodeV、VirtualLab等），熟练使用Matlab、Python等软件； (4) 具有光学系统建模仿真，干涉仪、精密仪器相关开发经验者优先； (5) 工作态度积极，吃苦耐劳，善于沟通，良好协调能力和团队合作精神。	hanxuerong@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
光电中心二组	机械工程师02	机械设计、机械工程、机械制造及其自动化等相关专业	<p>岗位职责：</p> <p>(1)超精密机械结构原理方案设计、仿真分析及实现；</p> <p>(2)精密机械系统结构仿真、热仿真；</p> <p>(3)精密机械系统集成与测试；</p> <p>(4)精密机械隔振设计。</p> <p>岗位要求：</p> <p>(1)熟练使用Solidworks、Ansys等机械设计、工程仿真软件；</p> <p>(2)能够进行公差分析、结构分析、热分析、振动分析等；</p> <p>(3)掌握精密机械加工工艺者优先；</p> <p>(4)具有精密仪器机械结构设计、静力学和动力学仿真分析经验者优先；</p> <p>(5)善于沟通，良好协调能力和团队合作精神。</p>	hanxuerong@ime.ac.cn
光电中心二组	电控工程师02	光学工程、自动化、电子技术、测控、精密仪器等相关专业	<p>岗位职责：</p> <p>1.负责项目中控制系统的软硬件研发，包括方案设计、仿真、硬件电路设计开发，软件编程及调试等；</p> <p>2.负责控制算法实现；</p> <p>3.控制硬件及软件研发相关技术文档编写；</p> <p>4.与其他专业研发人员协同工作。</p> <p>岗位要求：</p> <p>1.具有光学专业知识背景；</p> <p>2.熟悉C/C++/LABVIEW等编程语言及算法，具有较强的编程能力；</p> <p>3.熟练使用Altium Designer、Vivado等电路设计开发软件；</p> <p>4.熟悉FPGA等嵌入式硬件开发；</p> <p>5.具有光电设备测控研发或图像处理研发经验的人员优先。</p>	hanxuerong@ime.ac.cn
光电中心二组	电学工程师	电子、物理等相关专业	<p>岗位职责：</p> <p>(1)从事光源系统相关电源及电路系统分析评估，开展光源系统相关电源及电路系统的综合设计，提升光源系统输出性能、精度和稳定性；</p> <p>(2)从事相关电源及电路系统的技术开发和创新；</p> <p>(3)开发满足光源输出需求的电源及电路系统产品。</p> <p>岗位要求：</p> <p>(1)熟悉电源（特别是脉冲高压电源）的工作原理和总体架构，具有较强的电源及电路设计能力，具备较强的电路仿真（各类电路设计软件使用）、电路设计搭建，电路测试评估能力，可以配合其他专业开展系统测试评估验证；</p> <p>(2)熟练使用电路设计仿真软件，独立进行电路相关数据分析及电路板制作；</p> <p>(3)熟练掌握各类型电子器件知识及相关供应链信息，具备较强的学习沟通能力；</p> <p>(4)具备气体高压放电等离子体专业背景者优先。</p>	hanxuerong@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
光电中心三组	光学设计工程师02	光学工程、信息工程等相关专业	<p>岗位职责： 参与光路设计、机械设计、仿真工作，参与新型光电系统的光学规划论证、研究开发新型光电系统，参与光学、光路、光机结构设计，参与光电模块的系统设计和装调测试，负责光学器件的加工、跟产、验收、装调工作。</p> <p>岗位要求： (1) 信息与通信工程类、光学工程类相关专业，硕士及以上学历； (2) 良好的团队沟通及团队协作能力； (3) 具有良好的半导体激光器、集成光子芯片、混合集成激光器等专业知识； (4) 具有Crosslight (Pics3D、Lastip)、Rsoft、COMSOL、FDTD Solution、COMSOL、Matlab、Python、Tensor等有源和无源芯片的设计、光路仿真、电学和热学性能仿真等集成光子芯片一体化设计经验和能力者优先； (5) 有较强的设计仿真与实验动手能力，熟悉光子集成工艺优先。</p>	qiaozhi@ime.ac.cn
光电中心三组	光子集成设计工程师	光学工程、信息工程等相关专业	<p>岗位职责： 参与新型光电系统中，光电探测器、光电转换电路的设计与开发，参与电路板的设计、器件选型、加工跟产、焊接测试、系统联调工作，参与光电接口设计、安装与调试，研究新型光电信号探测电路系统，开展全波形高速信号采集系统研究。</p> <p>岗位要求： (1) 信息与通信工程类、光学工程类相关专业，硕士及以上学历； (2) 良好的团队沟通及团队协作能力； (3) 具有良好的半导体激光器、集成光子芯片、混合集成激光器等专业知识； (4) 具有Crosslight (Pics3D、Lastip)、Rsoft、COMSOL、FDTD Solution、COMSOL、Matlab、Python、Tensor等有源和无源芯片的设计、光路仿真、电学和热学性能仿真等集成光子芯片一体化设计经验和能力者优先； (5) 有较强的设计仿真与实验动手能力，熟悉光子集成工艺优先。</p>	qiaozhi@ime.ac.cn
光电中心四组	微纳光子集成器件设计工程师	应用物理、光学工程、电子科学技术	<p>岗位职责： 1) 无源、有源光子集成器件的设计； 2) 集成光学器件的片上集成； 3) 集成光学器件的实验表征。</p> <p>岗位要求： 1) 具有扎实的电磁学理论基础，在光子集成光学器件等方面具有研发和设计经验； 2) 有应用物理、光学、电子科学与技术等相关专业背景； 3) 熟练使用电磁仿真软件 (Lumerical FDTD、CST、等) 进行器件设计并完成器件表征； 4) 熟练阅读英文文献和论文撰写。</p>	cuihuirong@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
光电中心四组	激光技术与应用	光学工程, 物理, 光电子	岗位职责: 1) 激光系统的设计及调试; 2) 激光系统参数测试及稳定控制; 3) 激光系统在集成电路装备中的应用验证。 岗位要求: 1) 具有物理、光学相关专业背景或激光产品相关工作经验; 2) 掌握高能量激光系统及器件的设计; 3) 掌握非线性频率变换技术; 4) 熟悉机械加工工艺、装配等流程; 5) 沟通能力强, 有较强的责任心和团队意识。	cuihuirong@ime.ac.cn
新技术开发部存储器实验室	存储系统性能及可靠性优化算法研究	微电子、计算机、通信、自动化或相关专业	岗位职责: 存储系统固件开发, FTL及闪存近存算法设计 岗位要求: 1. 掌握存储系统固件开发流程, 熟练掌握C语言; 2. 具有嵌入式系统开发经验, 了解精简指令集; 3. 初步具备ARM、RISC-V等固件开发能力; 4. 兼有FPGA固件开发经验者优先; 兼有FTL开发经验者优先; 兼有近存计算开发经验者优先; 兼有了解存储系统架构者优先; 5. 工作有主动性, 具有责任感和团队合作的意识。	wangsining@ime.ac.cn
新技术开发部存储器实验室	先进工艺数字芯片设计研究	微电子或相关专业	岗位职责: 先进工艺芯片设计-数字方向 岗位要求: 1. 掌握集成电路设计流程, 熟练使用vcs/verdi等数字电路仿真工具; 2. 具有数字电路芯片(ASIC)RTL/Synthesis/STA等开发经验; 3. 初步具备数字电路设计及使用相关EDA工具开发的能力; 4. 兼有FPGA开发经验者优先; 兼有UVM验证经验者优先; 兼有先进工艺芯片开发经验者优先; 兼有存算一体芯片开发经验者优先; 兼有混合信号电路设计和测试经验优先; 5. 工作有主动性, 具有责任感和团队合作的意识。	wangsining@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
新技术开发部 存储器实验室	新结构3D NAND 闪存器件基础 研究	微电子学与固 体物理学、应 用物理学、电 子科学与技术 、集成电路	岗位职责： 1. 主要负责课题组半导体器件设计，尤其是新型存储器器件构架设计； 2. 主要负责完成半导体先导工艺研发与优化； 3. 完成半导体器件研发，尤其是新型存储器器件工艺整合及优化； 4. 半导体器件电学性能测试与分析； 5. 半导体器件可靠性性能测试与分析； 6. 完成领导交办的其他任务。 岗位要求： 1. 物理学、微电子学相关专业； 2. 熟练半导体器件及存储器器件基本原理； 3. 具备半导体工艺研发经验者优先； 4. 具备半导体生产线、研发线，尤其是8/12inch生产线、研发经验者优先； 5. 工作有主动性，具有责任感和团队合作的意识。	wangsining@ime.ac.cn
新技术开发部 存储器实验室	3D NAND闪存器 件制备及测试 分析	微电子学与固 体物理学、应 用物理学、电 子科学与技术 、集成电路	岗位职责： 1. 主要负责完成半导体先导工艺研发与优化； 2. 完成半导体器件研发，尤其是新型存储器器件工艺整合及优化； 3. 半导体器件电学性能测试与分析； 4. 半导体器件可靠性性能测试与分析； 5. 完成领导交办的其他任务。 岗位要求： 1. 物理学、微电子学相关专业； 2. 熟练半导体器件及存储器器件基本原理； 3. 具备半导体工艺研发经验者优先； 4. 具备半导体生产线、研发线，尤其是8/12inch生产线、研发经验者优先； 5. 工作有主动性，具有责任感和团队合作的意识。	wangsining@ime.ac.cn

部门	岗位名称	专业	岗位职责及岗位要求	简历筛选人邮箱
新技术开发部 存储器实验室	后端设计工程师	微电子、半导体物理、集成电路	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责模拟电路全定制版图设计、制定版图设计规范，协同开展迭代优化； 负责全芯片ESD、latchup可靠性设计版图方案； 负责版图数据交付验证及整合，解决流片过程中遇到的工艺问题； 撰写版图设计中的规范文件和设计文档等，协助完成各个阶段的技术支持； 参与数字电路及模拟电路的接口布线设计，协助测试工程师完成封装、测试等工作。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本科及以上学历，微电子等相关专业教育背景； 具有丰富的版图设计经验，熟悉前后端设计流程； 熟练使用cadence等EDA设计工具，具有良好的模拟电路基础； 熟悉制造工艺与电学测试，具有40nm及以下流片经验者优先； 具有责任感和良好的团队合作意识、沟通协调能力。 	wangsining@ime.ac.cn
新技术开发部 光刻测控组	光学工程师02	光学工程、电子信息信息等	<p>岗位职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责光学薄膜膜系设计、材料筛选、测试表征、损伤评估及相关建模计算；光学系统设计开发、调试及测试工作； 负责撰写相关技术资料； 与其他工程师合作，发现和解决问题以提高系统性能。 <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 熟练使用Macleod、Zemax等薄膜和光学设计软件，具有照明系统、成像系统等光学设计和集成测试经验； 有光电类仪器研发经验者优先； 有光刻相关项目经验者优先； 学习能力强，善于思考问题，踏实肯干，具备团队合作精神。 	pom@ime.ac.cn
新技术开发部 光刻测控组	光刻技术工程师	物理学、光学、光学工程等	<p>岗位职责：</p> <p>在光刻精密测量系统研发方向，负责光学系统物理光学模型建立与仿真分析，先进光电测试系统精密标定与光电测试设备开发。</p> <p>岗位要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 知名高校、科研院所取得博士学位不超过3年，应届毕业生优先； 年龄一般不超过35周岁； 具有物理学、光学、光学工程等相关专业背景； 掌握光栅、干涉测量、偏振照明等理论，熟悉光学设计、算法和软件开发，具有光刻方向研究经验者优先考虑； 具有较强的科研创新潜力和团队协作精神。 	pom@ime.ac.cn